



EVG® 850 NanoCleave™

レイヤー剥離装置



イントロダクション

IRレーザーでシリコン支持基板から層を正確に剥離する完全自動化システムEVG® NanoCleave™。

EVG850 NanoCleaveシステムは、赤外線(IR)レーザーと実証済の量産(HVM)対応プラットフォームで、特別に配合された無機剥離材料を用いて、シリコン支持基板から接合層、成膜層、または成長層をナノメートル精度で剥離することができます。

この革新的なプロセスにより、ガラス基板や有機接着剤が不要となり、処理温度の制限もなく、極薄層のトランスファーやそれに続くプロセスで必要とされる前工程との互換が可能になります。シリコン支持基板に無機剥離層を設けることで、こうした温度やガラス基板に関する互換性の問題が解決できます。

さらに、IRレーザーによる劈開はナノメートル単位の精度であるため、従来のプロセスを変更することなく、極薄デバイスウェーハの処理を可能にします。このような薄いデバイス層を積層することで、より広帯域幅での相互接続が可能になり、次世代高性能デバイス向けのダイ設計やセグメント化の新しい可能性が開かれます。

EVG850 NanoCleaveは、EVGの業界をリードするEVG850シリーズの全自動仮貼り合わせ/剥離およびシリコン・オン・インシュレータ(SOI)接合装置と同じプラットフォームをベースにしており、コンパクトな設計とHVMで実証されたウェーハ搬送システムを備えています。

特長

- 全自動フロントエンド対応HVM装置
- 最大300mmまでの基板サイズ (SEMI M1)
- 基板IDリーダーとSECS/GEM搭載
- ISO 3環境
- レーザー計測を含む使用時の完全なプロセス制御
- 露出後の基板を剥離するクリーブモジュール内臓

お問い合わせ

イーヴィグループジャパン株式会社
〒240-0005
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー1F
+81 45 348 0665

Sales@EVGroup.jp



www.EVGroup.com